

半導体パッケージにおける チップレット集積技術の最新動向と評価

- ◆日時：2026年5月18日(月) 13:00~16:15
- ◆受講料：1名につき49,500円(税込、資料付)
 - ※上記金額はライブ配信・アーカイブ配信いずれかの視聴料金です。申込欄でご選択ください。
 - ※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。
 - ・1名でお申込みされた場合、1名につき**39,600円**
 - ・2名同時にお申し込みされた場合、**2人目は無料(2名で49,500円)**
 - ・LIVE/アーカイブ配信両方視聴する場合は1名49,500円、2同時申込で名55,000円です。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

◆第1部 チップレット集積技術の最新動向

【講師】 東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所
特任教授 博士(工学) 栗田 洋一郎 氏

半導体集積回路の微細化限界が近づくのに伴い、チップレット集積技術は、素子集積規模のスケールアウトやデバイス構造の最適化、フォン・ノイマンボトルネックの解消、フレキシブルな異種集積など従来の集積回路技術の課題を解決する技術として期待されています。これまでの三次元集積技術の研究の歴史を踏まえながら、チップレット集積技術の最新動向、およびチップレット集積プラットフォーム・コンソーシアムでの活動状況についてお話しします。

【プログラム】 <13:00~14:30>

- チップレット集積技術の背景
 - 1-1. 半導体集積回路技術の歴史
 - 1-2. 半導体集積回路技術の課題と限界
 - 1-3. チップレット集積技術のモチベーション
- チップレット集積技術の歴史
 - 2-1. 3D集積技術の課題
 - 2-2. チップレット集積プラットフォーム技術への要求
 - 2-3. Siインターポーザ
 - 2-4. RDLインターポーザ
 - 2-5. Bridgeアーキテクチャ
- チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアム
 - 3-1. 体制と目標
 - 3-2. Bridgeアーキテクチャ
 - 3-3. HDRDL
 - 3-4. 3D集積
 - 3-5. 光集積
 - 3-6. 熱管理
- 世界の開発動向

◆第2部 チップレット実装のテストと評価技術

【講師】 愛媛大学 大学院理工学研究科
客員教授 博士(工学) 亀山 修一 氏

本講座では電子回路テストの基礎技術を紹介したうえでチップレットテストの考え方、真のKGD(Known Good Die)選別のためのテスト手法、ウェーハプローブの課題と最新動向、インターポーザのテスト、システムレベルテスト、SDC(サイレントデータ破損)、チップレット相互接続テストのためのバウンダリスキャンとIEEE 1838規格、TSV接続障害リペア方式とUCIe規格、ハイブリッドボンディングなど超狭ピッチTSV接続を評価するための新たな計測方法などを紹介する。

【プログラム】※詳細はHPでご確認下さい。 <14:45~16:15>

- はじめに
- チップレットの概要
- チップレットテストの動向
- チップレット間のインターコネクションテスト
 - 4.1. チップレットは小さな実装ボード
 - 4.2. 実装ボードの製造試験工程
 - 4.3. 実装ボードやチップレットの機能テストと構造テスト
 - 4.4. バウンダリスキャンの基礎知識
 - 4.5. IEEE 1149.1バウンダリスキャンテスト回路
 - 4.6. バウンダリスキャンテストによるはんだ接続不良検出動作例
 - 4.7. 積層ダイテストでのバウンダリスキャンテスト(IEEE 1838)
 - 4.8. チップ積層後のTSV接続障害復旧方式とUCIe規格
- TSVの接続品質評価技術

【WEBセミナーとは?】

- ・本講座は「Zoom」を使ったライブ配信セミナーです。「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Web ブラウザから参加するかの2種類がございます。Zoom WEBセミナーのはじめかた (<http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>) をご覧ください。
- ・お申込み後、受理のご連絡メールをさせていただきます。文面が通常セミナー形式(受講券、請求書、会場の地図)になっておりますが、LIVE配信のみのセミナーです。
- ・事前に接続テスト用のURL (<https://zoom.us/test>) から「ミーティングテストに参加」を押していただき動作確認をお願いします。
- ・後日、別途視聴用のURLをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時の5分前に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
- ・セミナー資料(テキスト)は事前にPDFでお送りします。
- ・タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。

『チップレット集積技術』WEBセミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒LIVE アーカイブ

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	
お名前	所属	E-Mail	
①			
②			
会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。		<input type="checkbox"/> Eメール <input type="checkbox"/> 郵送	

●Webセミナーの受講申込みについて●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。上記のLIVEかアーカイブにチェックを入れて下さい。弊社から受付完了のご連絡をいたしまして請求書をお送りいたします。セミナーお申込み後、ご都合により出席できない場合、ご都合により出席できない場合は代理の方がご出席下さい。代理の方も見つからない場合、営業日(土日祝日を除く)で8日前まででしたらキャンセルをお受けします。

受講料の支払いに関してはHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>



株式会社 R & D 支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル 7F
TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) <http://www.rdsc.co.jp/>